

第一节 重要提示  
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事、监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中披露具体原因和其人姓名。

四、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年利润分配方案为：公司以实施基差派息方式拟将每10股派发现金红利人民币16.30元（含税），拟合计分配现金红利总额为263,988,946.78元（含税）。公司2024年利润分配方案经公司六届四十二次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。

公司已于2024年12月18日完成上述2024年期间利润分配方案，公司以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户上回购股份后的总股本为基础，每10股派发现金红利2.00元（含税），拟合计派发现金红利239,979,343.20元。

2024年度预计现金红利金额占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.16%。

第二节 公司基本情况

公司概况简介		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永华	周舒扬
联系地址	上海市浦东新区上科路88号	上海市浦东新区上科路88号
电话	021-58085043	021-58085043
传真	021-50152760	021-50152760
电子信箱	will_stock@corp.oriental.com	will_stock@corp.oriental.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业情况  
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

(二)行业经营情况

1.全球半导体行业发展趋势  
根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新的秋季预测，2024年全球半导体市场将实现19.0%的增长，达到2.70万亿美元。WSTS预计今年的预测数据将进一步上调。这一趋势反映了全球半导体市场的增长趋势。2023年第二季度和第三季度的预测特别提到了计算领域。从区域来看，不同于2023年的下滑表现，2024年美国半导体市场规模预计将实现38.5%的增长，而中国大陆半导体市场规模预计将实现17.5%的增长。

展望2025年，WSTS预测全球半导体市场规模将增长11.2%，预计将达到6.97亿美元。这一增长预计将主要由内存和逻辑部门推动，这两个部门有望在2025年提升至4,000亿美元以上，内存和逻辑部门的增长率将分别达到13%和17%。WSTS预计所有其他部门都将录得个位数的增长率。2025年，所有地区的都将继续保持两位数的增长率。

2.国内半导体行业发展趋势  
近年来，随着数字化和智能化趋势的不断加强，国内集成电路市场需求逐步增长，中国作为全球最大的半导体生产基地之一，集成电路的进出口贸易规模一直都是非常重要的位置。2024年，中国集成电路出口数量保持向好态势。根据中国海关总署最新数据，2024年，中国累计出口集成电路5,492亿颗，同比增长14.5%；进口2.74万亿美元，同比增长11.4%；2024年，中国累计出口集成电路金额1.14万亿美元，同比增长18.6%，再创历史新高。

公司半导体设计销售业务是典型的Fabless模式，公司从仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给晶圆代工厂商，封装测试厂商，委托集成电路设计企业进行封装测试。

公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系统构成。具体产品包括但不限于：

业务	产品名称	主要功能	应用领域
图像传感器解决方案	Cmos图像传感器	将接收的光学信号转换成电信号，是数字摄像机、消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域的核心部件。	消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等
视觉系统集成封装	硅基液态投影显示模组	采用硅基液态材料整合成高分辨率光学模组，实现图像处理、感知、识别、定位、跟踪、测量、识别等功能。	医疗、物联网、图像识别、AR/VR等
触控显示集成电路产品(ASIC)	硅基液态投影显示模组	支持公司产品线在摄像头和手机上的触控功能的应用，提供USB-C、HDMI、Type-C等连接方式，以及压感触控的应用，从而更好地满足客户的需求。	汽车、安防等
显示解决方案	触控和显示驱动集成芯片(TDOL)	触控手写输入的数据接口，驱动LCD显示，配合触控笔，实现手写输入的功能。	智能手写、智能手机
显示驱动芯片(DIC)	显示驱动集成芯片(TDOL)	将传统的TOP-EM驱动器驱动结合到一个由中小尺寸显示单元的单片，实现了“DD”的高密度矩阵，更高的BOM成本及功耗和时间的降低。	笔记本电脑
TVS	提供全系统的静电防护及浪涌吸收能力	消费电子、安防、网络通信、汽车等	
MOSFET	提供全系统的静电防护及浪涌吸收能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	
肖特基二极管	肖特基二极管	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	
LDO	LDO	提供全系统的静电防护及浪涌吸收能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等
DC-DC	DC-DC	提供全系统的静电防护及浪涌吸收能力	消费类电子如笔记本电脑、电视、机顶盒等
LED背光驱动	LED背光驱动	构造一个逆变电源电路，确保任何条件下背光LED发光的亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等
摄像头	摄像头	负责感知环境和控制驱动等功能，实现对环境的感知和控制。	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
CAN芯片	通过LIN总线以广播形式实现总线通信，通过CAN总线实现点对点通信，满足汽车、摩托车、工程机械、轨道交通、航空航天等领域的应用需求。	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	
LIN芯片	通过采用LIN总线以广播形式实现总线通信，满足汽车、摩托车、家电、智能家居、轨道交通、航空航天等领域的应用需求。	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	
SIC	SIC	实现了汽车网联功能，通过监控、检测、安全监测等特性。	汽车电子、控制、物联网、安防等
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash、传感器、三极管等	实现了汽车网联功能，通过监控、检测、安全监测等特性。	汽车电子、控制、物联网、安防等
射频器件	射频器件	提高信号的传输效率，降低成本。	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等

(五)公司作为代理销售产品的具体情况  
公司作为典型的半导体授权代理销售商，与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的FAE队伍，顺应国内半导体企业的地域分布，公司代理销售体系遍布全国各地设立了子公司，构建采购、销售网络，提供技术支持、售后服务及完善的物流服务。

代理销售的产品分为元件类、结构器件、机电系统、仪器仪表、汽车部件等技术服务类等多领域。

产品名称 主要应用  
CMOS图像传感器 将接收的光学信号转换成电信号，是数字摄像机、消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域的核心部件。

视觉系统集成封装 硅基液态投影显示模组和CMOS图像传感器的感知部分，可以提供图像处理、感知、识别、定位、跟踪、测量、识别等功能。

触控显示集成电路产品(ASIC) 特定用途集成电路产品(ASIC) 提供触控功能的应用，能通过USB-C、HDMI、Type-C等连接方式，以及压感触控的应用，从而更好地满足客户的需求。

显示驱动芯片(DIC) 显示驱动集成芯片(TDOL) 将传统的TOP-EM驱动器驱动结合到一个由中小尺寸显示单元的单片，实现了“DD”的高密度矩阵，更高的BOM成本及功耗和时间的降低。

TVS 提供全系统的静电防护及浪涌吸收能力

MOSFET 提供全系统的静电防护及浪涌吸收能力

肖特基二极管 肖特基二极管

LDO LDO

DC-DC 静电防护及浪涌吸收能力

LED背光驱动 LED背光驱动

摄像头 摄像头

CAN芯片 CAN芯片

LIN芯片 LIN芯片

SIC SIC

集成电路 集成电路

射频器件 射频器件

CMOS图像传感器

视觉系统集成封装

触控显示集成电路产品(ASIC)

显示驱动芯片(DIC)

集成电路

肖特基二极管

LDO

DC-DC

LED背光驱动

摄像头

CAN芯片

LIN芯片

SIC

集成电路

射频器件

CMOS图像传感器

视觉系统集成封装

触控显示集成电路产品(ASIC)

显示驱动芯片(DIC)

集成电路

肖特基二极管

LDO

DC-DC

LED背光驱动

摄像头

CAN芯片

LIN芯片

SIC

集成电路

射频器件

CMOS图像传感器

视觉系统集成封装

触控显示集成电路产品(ASIC)

显示驱动芯片(DIC)

集成电路

肖特基二极管

LDO

DC-DC

LED背光驱动

摄像头

CAN芯片

LIN芯片

SIC

集成电路

射频器件

CMOS图像传感器

视觉系统集成封装

触控显示集成电路产品(ASIC)

显示驱动芯片(DIC)

集成电路

肖特基二极管

LDO

DC-DC

LED背光驱动

摄像头

CAN芯片

LIN芯片

SIC

集成电路

射频器件

CMOS图像传感器

视觉系统集成封装

触控显示集成电路产品(ASIC)

显示驱动芯片(DIC)

集成电路

肖特基二极管

LDO

DC-DC

LED背光驱动

摄像头

CAN芯片

LIN芯片

SIC

集成电路

射频器件

CMOS图像传感器

视觉系统集成封装

触控显示集成电路产品(ASIC)

显示驱动芯片(DIC)

集成电路

肖特基二极管

LDO

DC-DC

LED背光驱动

摄像头

CAN芯片

LIN芯片

SIC